

## 芯联集成电路制造股份有限公司

### 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

#### 一、2024年年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	650,893.60	532,448.28	22.25
营业利润	-225,657.02	-294,213.22	减亏 23.30%
利润总额	-225,329.51	-294,142.88	减亏 23.39%
归属于母公司所有者的净利润	-96,805.50	-195,833.18	减亏 50.57%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-138,035.44	-226,168.58	减亏 38.97%
研发费用	183,918.25	152,917.89	20.27
EBITDA (息税折旧摊销前利润)	214,141.83	92,541.68	131.40
基本每股收益（元）	-0.14	-0.32	不适用
加权平均净资产收益率	-8.02%	-22.44%	增加 14.42 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	3,423,485.94	3,157,036.64	8.44

归属于母公司的 所有者权益	1,232,157.94	1,248,307.47	-1.29
股本	705,908.70	704,460.23	0.21
归属于母公司所有者的 每股净资产（元）	1.75	1.77	-1.13

注：

- 1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
- 2、以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列，未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。
- 3、表格中的数据尾差为四舍五入所致。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

### （一）报告期的经营情况、财务情况及影响经营业绩的主要因素

#### 1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内，预计公司实现营业总收入 650,893.60 万元，同比增长 22.25%，其中主营业务收入 627,615.07 万元，同比增长 27.80%；归属于母公司所有者的净利润为-96,805.50 万元，同比减亏 50.57%；归属于母公司所有者的扣除非经营性损益的净利润为-138,035.44 万元，同比减亏 38.97%；基本每股收益为-0.14 元，同比减亏 56.25%。

报告期末，预计公司总资产为 3,423,485.94 万元，同比增长 8.44%；归属于母公司的所有者权益为 1,232,157.94 万元，同比减少 1.29%；归属于母公司所有者的每股净资产为 1.75 元，同比减少 1.13%。

#### 2、影响经营业绩的主要因素

2024 年，公司秉持“市场+技术”双轮驱动的发展战略，通过与国内外新能源和高端消费类终端客户、Tier1 等头部企业以及广大设计公司的全面和深入合

作，已经成长为新能源、智能化产业核心芯片的支柱性力量。同时公司全力构建汽车、AI、消费、工控四大领域增长引擎，重点布局新能源和 AI 人工智能两大应用方向。报告期内，公司实现营业收入约 65.09 亿元，同比增加约 11.84 亿元，同比增长约 22.25%；实现主营业务收入约 62.76 亿元，同比增长约 27.80%。在夯实以硅基功率为主的第一增长曲线外，公司第二增长曲线 SiC 业务实现收入 10.16 亿元，与第三增长曲线模拟 IC 业务均较上年增长超 100%。2024 年公司已实现年度毛利率转正约 1.07%，同比增长约 7.88 个百分点，归母净利润大幅改善，同比减亏约 50.57%。EBITDA 实现 21.41 亿元，同比增长 131.40%；EBITDA 利润率 32.90%，同比增长 15.52 个百分点。

在车载领域，公司已布局整车约 70% 的汽车芯片平台数量，配套的汽车芯片以功率芯片及模组、传感类为主，提供数字/模拟/功率器件完整代工方案。通过与终端客户深度合作，创新引领，为车规芯片国产化提供系统代工方案。2024 年，公司实现车载领域收入约 32.53 亿元，同比增加约 9.46 亿元，增长约 41.02%。

在高端消费领域，公司布局消费电子和智能家居，提供麦克风、惯性传感器、压力传感器、微镜、滤波器、VCSEL 等完整的代工平台。在消费电子方面，硅麦克风产品性能覆盖 58dB-72dB，主要覆盖高端手机、TWS 耳机、电子烟、车载麦克风等；手机锂电池保护芯片实现该领域大规模国产替代的唯一一家，技术平台对标国际顶尖水平；惯性传感器(加速度和陀螺)应用可覆盖消费类 IMU，如手机、TWS 耳机等；IMU 和 MEMS 微镜已实现终端客户验证；消费类 VCSEL 产品已量产，持续放量增长。在智能家居方面，智能功率模块 IPM、大功率 PIM 模块和分立器件产品型号完整，广泛覆盖空冰洗、智能家居、热管理系统等领域，家电终端批量生产。报告期内公司实现消费领域收入约 19.21 亿元，同比增加约 7.64 亿元，增长约 66.03%。

在工控领域，公司布局风光储和超高压领域，覆盖风光储充氢、变频等领域头部客户，提供核心模拟器件解决方案。其中风光储充氢新能源领域，公司 120KW 和 150KW 光伏逆变模块产品在工商业光伏国内市场份额超过 10%，220KW、125KW 和 MW 级功率模块在储能客户端开始批量生产；新型电力系统领域，应用于高压输配电的 4500V IGBT 成功挂网应用一年以上，已实现量产。

在 AI 领域，公司携手设计公司和终端客户，加强 AI 新兴应用领域的研发和工艺平台开发，为智能传感器、AI 服务器电源等产品提供最完善的代工平台。在数据中心 AI 服务器电源应用上，180nm BCD 应用于 AI 服务器和 AI 加速卡的电源管理芯片已实现大规模量产；应用于电源管理的 MOSFET 芯片已实现量产；55nm BCD 20V 集成 DrMOS 客户产品验证完成。在机器人应用上，MEMS 传感器及功率类芯片代工产品成功量产，可覆盖麦克风，惯性、压力传感器以及激光雷达光源和扫描镜，用于语音交互、姿态识别、运动捕捉、机械手抓取与操作、环境感知、导航定位等；同时提供功率器件、功率 IC 及电源管理芯片代工。

2025 年，随着新平台、新应用推广及新产能投产，公司在模拟 IC、模组、SiC 及 MEMS 业务将增长显著。同时，以 AI 服务器为代表的新型电源需求的全面支撑及产品代工推动，预计公司将迈入新一轮高速增长期。叠加公司运营管理效率进一步提升、高效的供应链管理及主要生产设备逐渐出折旧期等有利因素，公司毛利率将稳步提升，净利润也将取得明显突破，争取 2026 年实现全面的、有厚度的盈利转正。

## （二）上表中有关项目增减变动幅度达到 30% 以上的主要原因说明

报告期内公司归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别同比减亏 50.57%、38.97%，EBITDA 同比增加 131.40%，主要系报告期内公司收入规模扩大，产能利用率提高，重大降本项目持续推进，

现金毛利率增加，从而提升了公司主营产品的盈利能力；同时报告期内公司与收益相关的政府补贴较上年同期有所增加。

### 三、风险提示

本公告所载公司 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日